

产品介绍

TIG[®]7835L 液态金属通过新材料技术与合金化工艺，实现常温下液态形态与低表面张力特性（区别于普通金属需加热至熔点液化），兼具高流动性与优异导热性，且不易蒸发、不易泄漏、安全无毒、物化性质稳定，作为散热领域底层技术，能为大功率散热需求提供全面高效解决方案，适配未来芯片集成度提升趋势，可保障散热系统长期稳定运行

产品特性

- 优异的导热率
- 无毒环保安全，满足RoHS要求
- 优秀的长期稳定性
- 彻底填铺接触表面，创造低热阻
- 不易挥发

应用范围

- 微处理器、AI芯片
- 图形处理芯片
- 机顶盒、笔记本
- LED电视、LED灯具
- 液冷散热



产品规格

1ml/支，30ml/支，50ml/支，针筒装
如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。

TIG [®] 7835L 特性表		
性能指标	数值	测试方法
颜色	银白色	目视
形态	液态	目视
结构&成份	镓合金	-
密度 (g/cm ³) @25°C	6.5	ASTM D792
导热系数 (W/m·K) @25°C	35.0	ISO22007
比热容 (J/g·°C) @25°C	0.39	ASTM E1269
电阻率 (Ω·m)	< 10 ⁻⁴	ASTM D257
粘稠度 (mPa·s)	<10	GB/T 10247
熔点范围 (°C)	>9	ASTM D3418
凝固点范围 (°C)	< -28	ASTM D3418
建议使用温度范围 (°C)	-40~250	-
RoHS标准	符合	-

全球方案：在地服务

中国：+86-769-38801208
台湾：+886-2-2277-1007
加拿大：+001-604-2998559
越南：+84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIG7835L-0726

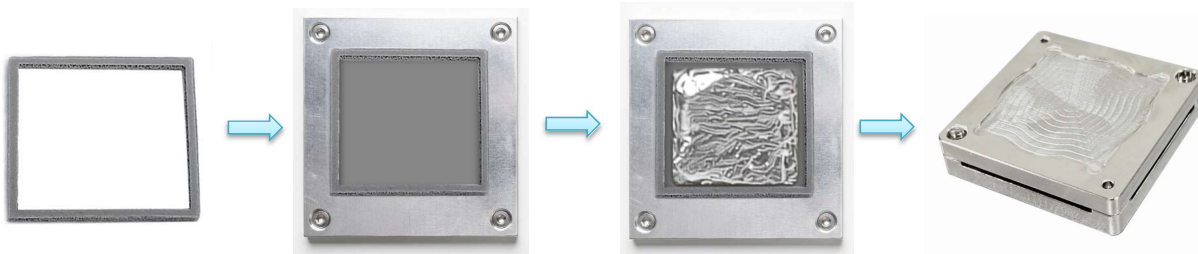
产品介绍

本产品采用Z-FOAM[®]800-10SC-NS3-A2 泡棉框，依托专利号 CN224218815U 的液态金属封装结构完成密封封装。泡棉选用优质原料并搭载独特微孔结构，受压后回弹速度快，可充分填充装配间隙，形成长效稳定密封层。材料可耐受大幅温差波动与长期持续压缩载荷，全程维持稳定密封性能，兼具降噪效果，有效提升设备运行效率、降低整机能耗。该新型封装结构不仅实现超高热传导效率，还可在设备加压工况下可靠锁住液态金属，杜绝泄漏风险。

封装结构：



封装步骤：



使用说明

- 1、使用前应保证热源与散热器表面干燥且无任何残留物。
- 2、使用前应先在室温下静置至少4小时。
- 3、液态金属具有优异的导电性，应避免其与电路板等直接接触造成短路。
- 4、镓基液态金属易与部分金属，如铝发生反应，造成结构脆化，若需要与铝接触，请先做好阳极处理，但敝司不保证其长期稳定性。
- 5、开封后请加盖保存在温度为30℃以下且相对湿度为65%RH以下的环境，否则将产生氧化与水解反应，建议3天内使用完毕。

注意事项

- 1、本材料对铝材造成腐蚀，应避免直接接触。
 - 2、在涂抹本材料后，建议用适合的泡绵或垫片，沿着液态金属的边缘进行围固，确保材料不流散或扩散。
 - 3、当施加压力大于 10Psi 时，本材料有可能容易出现表面变干的现象。
- 如想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

全球方案：在地服务

中国：+86-769-38801208
台湾：+886-2-2277-1007
加拿大：+001-604-2998559
越南：+84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIG7835L-0726